

深圳丹邦科技股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1373 号”文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,107,300.00 元，实际募集资金净额为人民币 495,892,700.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2011]3-55 号验资报告。

（二）募集资金的使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日止，本公司 2012 年度使用资金情况为：

项目	单位:人民币万元 募集资金金额
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金净额	27,078.90
减：2012 年度募投项目支出	20,021.65
2012 年度超募项目支出	7,093.51
手续费支出	1.14
加：2012 年度专户利息收入	87.52

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2011年10月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年12月与中国工商银行股份有限公司侨城西街支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2012年12月31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000093229100007218	381,243.91	
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	111,526.06	
中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行	4000093229100009270	8,385.25	账户名称：广东丹邦
<u>合计</u>		<u>501,155.22</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）超募资金的使用情况

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》（该议案已于

2012年1月5日经公司2012年第一次临时股东大会批准)，公司决定使用超募资金70,892,700.00元投资建设柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目。截止到报告期末，该项目已使用超募资金7,093.51万元(超额部分为账户利息收入)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			49,589.27	本年度投入募集资金总额		27,115.16							
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		49,678.15							
变更用途的募集资金总额比例				无									
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	否	42,500.00	42,500.00	42,500.00	20,021.65	42,584.64	84.64	100.20%	2013年6月 30日	0.00	不适用	否
募投项目小计			42,500.00	42,500.00	42,500.00	20,021.65	42,584.64	84.64	100.20%				
2	柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	否	7,089.27	7,089.27	7,089.27	7,093.51	7,093.51	4.24	100.06%	2013年6月 30日	0.00	不适用	否
超募项目小计			7,089.27	7,089.27	7,089.27	7,093.51	7,093.51	4.24	100.06%				
合计			49,589.27	49,589.27	49,589.27	27,115.16	49,678.15	88.88					
未达到计划进度原因(分具体项目)			<p>公司募集资金投资项目按照公司在首次公开发行并上市时相关文件中所披露的投资进度及建设周期,应于2013年下半年达到预定可使用状态。超募资金投资项目原定于2013年上半年达到预定可使用状态。由于投资及建设进程加快,在2011年年度报告及2012年半年度报告披露时点,公司预计募集资金投资项目及超募资金投资项目达到预定可使用状态的时间将有所提前,分别提前至2012年12月30日及2012年11月30日。</p> <p>截至2012年12月31日,上述投资项目中部分生产设备仍处于安装、调试阶段,部分生产人员正在招聘、培训过程中,同时公司尚在办理相关验收手续,故上述投资项目尚未达到预定可使用状态。</p>										

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			49,589.27					本年度投入募集资金总额			27,115.16		
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额			49,678.15		
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》(该议案已于2012年1月5日经公司2012年第一次临时股东大会批准),公司决定使用超募资金7,089.27万元投资建设柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目。截止到报告期末,已使用超募资金7,093.51万元(超额部分为账户利息收入)。										
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况			募集资金投资项目实施地点未变更。										
募集资金投资项目实施方式			募集资金投资项目实施方式未调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司决定使用募投项目资金置换截止到2011年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币20,072.07元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			尚未使用的募集资金50.12万元存放于公司募集资金专户,系利息收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无										